

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）的核准，公司非公开发行不超过 78,005,377 股新股，截至 2020 年 12 月 23 日，公司本次非公开发行人民币普通股 47,749,661 股，发行价格 28.79 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,374,712,740.19 元，扣除各项不含税发行费用人民币 20,184,669.49 元后，募集资金净额为人民币 1,354,528,070.70 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 23 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》[众会字（2020）第 8380 号]。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,374,712,740.19
减：发行费用-承销费（含税）	19,000,000.00
募集资金到账	1,355,712,740.19
减：募投项目-补充流动资金	404,610,133.29

减：暂时补充流动资金	284,000,000.00
减：永久补充流动资金金额	88,466,521.39
减：支付发行费用	1,648,000.00
减：投入募投项目-半导体湿法清洗设备扩产项目	198,598,430.90
减：投入募投项目-光电子材料及器件制造基地建设项目	280,808,753.06
减：半导体晶圆再生二期项目	22,932,100.00
减：单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目	77,416,720.40
减：手续费	7,723.87
减：其他划款	5,832.51
加：其他划款	1,880.00
加：利息收入	3,466,621.20
募集资金余额	687,025.97

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2020年12月29日分别与兴业银行股份有限公司上海市南支行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

募集资金专户的具体情况如下表所示：

开户行	账号	初始存放金额 (元)	2025年6月30 日余额(元)
兴业银行上海市南支行	216350100100120053	1,355,712,740.19	已销户
杭州银行股份有限公司上海分行-江苏启微	3101040160001981296	-	已销户
兴业银行股份有限公司上海市南支行-合肥至微半导体	216350100100120688	-	已销户
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行-天津波汇	50131000832243490	-	已销户
兴业银行上海卢湾支行	216120100100259971 (注1)	-	687,025.97

上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行-科谱天津	50131000831666234	-	公司已出售 (注 2)
合计		1,355,712,740.19	687,025.97

注 1：公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的议案》，将“半导体晶圆再生二期项目”变更为“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”，并已重新签订三方监管协议，变更后新项目的开户行为兴业银行股份有限公司上海卢湾支行，专户账号为 216120100100259971。

注 2：公司于 2022 年 4 月 12 日公告，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过将本次发行“光电子材料及器件制造基地建设项目”的实施主体由天津波汇、科谱半导体两个实施主体变更为由天津波汇实施，该募投项目的实施内容、实施方案均保持不变。变更后募集资金存放于上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行-天津波汇账户中。科谱半导体后续已于 2022 年 12 月完成出售。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见附表 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未进行募集资金投资项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2024 年 10 月 29 日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中不超过人民币 29,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至报告期期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为 28,400.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的议案》。公司结合 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目的进度情况，将募投项目“半导体湿法清洗设备扩产项目”节余的募集资金永久补充流动资金；将募投项目“半导体晶圆再生二期项目”变更为新项目“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”。该募投项目变更事项已经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体变更情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1：募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行股票）

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表
(2020 年非公开发行股票)

单位：万元

募集资金总额				135,571.27		本年度投入募集资金总额					686.07	
变更用途的募集资金总额				36,202.88		已累计投入募集资金总额					107,283.26	
变更用途的募集资金总额比例				26.70%								
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
半导体湿法清洗设备扩产项目	否	25,500.00	25,500.00	19,859.84	-	19,859.84	0	100.00	2024 年	（注 5）	否	否
半导体晶圆再生二期项目	是	59,000.00	2,293.21	2,293.21		2,293.21		100.00	（注 4）	（注 4）	（注 4）	是
单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目			36,202.88	36,202.88	686.07	7,741.67	-28,461.21	21.38	2026 年 11 月	不适用	不适用	否
光电子材料及器件制造基地建设项目	否	46,000.00	31,000.00	28,080.88	-	28,080.88	0	100.00	2024 年 12 月	271.07	否	否
补充流动资金或偿还债务	—	55,500.00	40,600.00	40,600.00	-	40,461.01	-138.99	99.66		不适用	不适用	否
剩余募集资金永久补充流动资金	—	不适用	不适用	-	-	8,846.65（注 6）						
合计	—	186,000.00	135,596.09（注 7）	127,036.81	686.07	107,283.26	-28,600.20	77.49（注 8）	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					2021 年至今，一方面受外部国际环境和产业背景影响，国内晶圆厂产线的设备总体稼动率不足，使得国内晶圆再生业务的总体市场规模增长受限；另一方面，近两年来多家国内企业开始涉足该领域，市场价格逐渐下行，竞争趋于激烈。经过管理层深入且审慎的评估，认为继续投资该业务板块可能存在投资回报率偏低、利润提升有限的情况，故公司将募投项目“半导体晶圆再生二期项目”变更为新项目“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的公告》（公告							

	编号：2023-114）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（三）之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	“半导体湿法清洗设备扩产项目”产生节余募集资金 5,746.98 万元，主要因公司在设备采购过程中，积极通过采购比价、供应链管理等手段有效地控制成本，“设备购置及安装”项目实际投入比计划节约超过 20%。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-114）。 “光电子材料及器件制造基地建设项目”产生节余募集资金 3,095.77 万元，主要系 1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用；2、由于部分项目工程及设备支付周期较长，部分验收款、质保金等款项尚未达到支付条件；3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-116）。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及剩余募集资金永久补充流动资金金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：2023 年 12 月 7 日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，“半导体晶圆再生二期项目”变更为新项目“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”，调整后的投资总额为截止至变更时实际发生的投资金额。

注 5：“半导体湿法清洗设备扩产项目”系实施主体江苏启微新增产能项目，无法单独核算效益。目前该项目已建设完毕，但由于 2022 年后国际贸易摩擦和地缘政治等因素，公司重点服务的下游领域扩产计划推迟，导致公司半导体湿法清洗设备新签订单及设备交付进度不达预期，项目实施主体江苏启微总体收入及利润均未达到预期水平。

注 6：“半导体湿法清洗设备扩产项目”和“光电子材料及器件制造基地建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额与剩余募集资金永久补充流动资金之间的差异为利息收入所致。

注 7：由于项目变更，调整后的投资总额合计与募集资金净额 135,571.27 万元的差异为利息收入所致。

注 8：不考虑剩余募集资金永久补流金额 8,846.65 万元的影响。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目	半导体晶圆再生二期项目	36,202.88	36,202.88	686.07	7,741.67	21.38	2026 年 11 月	不适用	不适用	否
合计	—	36,202.88	36,202.88	686.07	7,741.67	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			2021 年至今，一方面受外部国际环境和产业背景影响，国内晶圆厂产线的设备总体稼动率不足，使得国内晶圆再生业务的总体市场规模增长受限；另一方面，近两年来多家国内企业开始涉足该领域，市场价格逐渐下行，竞争趋于激烈。经过管理层深入且审慎的评估，认为继续投资该业务板块可能存在投资回报率偏低、利润提升有限的情况，故公司将募投项目“半导体晶圆再生二期项目”变更为新项目“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-114）。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							